

杭州士兰微电子股份有限公司

对外投资完成公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资概述

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 11 月 8 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于向士兰集科增资暨关联交易的议案》和《关于向士兰明镓增资暨关联交易的议案》：

1、同意公司与厦门半导体投资集团有限公司（以下简称“厦门半导体投资集团”）按目前股权比例，以货币方式同比例认缴厦门士兰集科微电子有限公司（以下简称“士兰集科”）本次新增的全部注册资本 50,049 万元，其中：本公司认缴 7,507.35 万元；厦门半导体投资集团认缴 42,541.65 万元。本次出资无溢价。本次增资完成后，士兰集科的注册资本由 200,000 万元增加为 250,049 万元。

2、同意公司与厦门半导体投资集团按目前股权比例，以货币方式同比例认缴厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（以下简称“士兰明镓”）新增的全部注册资本 17,037 万元，其中：本公司出资 5,111.10 万元；厦门半导体投资集团出资 11,925.90 万元。本次出资无溢价。本次增资完成后，士兰明镓的注册资本由 80,000 万元增加为 97,037 万元。

上述事项详见公司于 2019 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-047）。

二、投资完成情况

士兰集科和士兰明镓各股东已于近日分别完成了上述新增注册资本的全部增资款的缴纳事项，具体如下：

1、增资缴款完成后，士兰集科的股权结构及实收资本情况如下所示：

股东名称	认缴注册资本	实缴注册资本	持股比例
------	--------	--------	------

	(万元)	(万元)	(%)
厦门半导体投资集团有限公司	212,541.65	212,541.65	85.00
杭州士兰微电子股份有限公司	37,507.35	37,507.35	15.00
合计	250,049.00	250,049.00	100.00

2、增资缴款完成后，士兰明镓的股权结构及实收资本情况如下所示：

股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例 (%)
厦门半导体投资集团有限公司	67,925.90	67,925.90	70.00
杭州士兰微电子股份有限公司	29,111.10	29,111.10	30.00
合计	97,037.00	97,037.00	100.00

截至本公告披露日，本次对外投资事项已实施完成。

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2020年9月2日